

Pulse-reverse 전해도금 조건에 따른 빌드업 PCB 도금층의 특성 평가

서민혜*, 홍현선, 정운석¹, 이덕행¹
고등기술연구원; ¹(주)호진플라텍
(minhye_s@iae.re.kr*)

경제 성장의 중추적 역할을 하고 있는 Printed Circuit Board (PCB) 산업은 국내 주력 수출제품이며, TV, VTR 등의 전통적 전자제품 뿐 아니라 컴퓨터, 휴대폰, 디스플레이, 통신네트워크, PDA 등의 IT 제품 등에 폭넓게 사용되고 있다. 그 중 빌드업 방식으로 제조한 PCB 기판은 전자 부품의 경박·단소화를 이끌 수 있는 주요 부품으로써 활용될 수 있다.

본 연구에서는 빌드업 PCB 기판에 이용이 가능한 펄스-리버스 동 도금기술 개발의 기초연구로써 도금을 위한 전해조건 및 전해액의 조성 변화에 따라 구리 도금표면의 형상변화에 대해 알아보고자 하였다. 또한 각 조건별로 얻은 도금시편에 대해 도금된 피막의 연신율과 인장강도 분석으로 내구성이 있는 도금피막 제조를 위한 연구를 실시하였다.